

高导热高可靠性导热硅脂

TG600是一款具有高导热系数的导热硅脂。该产品不含有金属导热填料，耐热性、长效性、可靠性佳，同时低BLT厚度可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻，广泛应用于PCB系统组件与光伏逆变器的热管理上。



特性和优点

- 导热系数6.0W/(m·K)
- 不含金属填料颗粒，高绝缘
- 低游离度
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻

典型应用

- 网络通讯装备—无线模块、路由器
- 消费类电子—游戏系统、便携设备
- 工业工控设备
- PCB散热组件
- 光伏逆变器
- 高功率LED照明

典型属性

属性	典型值	测试方法
颜色	白色	目视
密度(g/cc)	3.2	ASTM D792
挥发份(%)	≤0.5	@150°C/24h
硅脂状态	流淌	目测
粘度(cP)	510000	DV2T-T96-12Rpm
锥入度(0.1mm @25°C)	266	GB/T269
耐温范围(°C)	-40~150	/
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
电性能		
击穿电压(kV/mm)	≥5	ASTM D149
体积电阻率(Ω·cm)	10 ¹²	ASTM D257
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	6.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in ² /W @50psi,80°C)	≤0.017	ASTM D5470